附件1：

|  |
| --- |
| **申报资料分类对照表** |
| **项目大类序号** | **项目大类名称** | **项目子类别序号** | **项目子类别名称** |
| 一 | 支持集成电路企业加快发展类 | 1-1 | 首次全掩膜（Full Mask）工程产品和多项目晶圆（MPW）流片 |
| 1-2 | 采购本地企业自主研发设计生产的芯片 |
| 1-3 | 向 IP提供商购买IP进行研发 |
| 1-4 | 设计平台提供IP复用、共享设计工具软件等服务 |
| 1-5 | 化合物半导体全掩膜首轮验证性流片 |
| 1-6 | 在本地进行封装和测试 |
| 二 | 鼓励高校院所支持集成电路产业发展类 | 2-1 | 国际国内一流高校在蓉建设国家示范性微电子学院、在蓉高校或科研院所新设立微电子相关专业的学院 |
| 2-2 | 在蓉高校科研院所扩大集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士招生规模 |
| 2-3 | 在蓉高校科研院所集成电路设计相关专业学生教学流片 |
| 2-4 | 在蓉高校科研院所承接本地设计企业急需的技术攻关 |
| 三 | 为产业发展提供创新支撑类 | 3-1 | 新获批省级和国家级博士后工作站 |
| 3-2 | 重点企业与高校科研院所共建集成电路设计类工程技术研发中心 |
| 3-3 | 企业自主兴办集成电路设计类职业培训机构 |
| 3-4 | 重点企业与高校科研院所共建综合培训实践基地 |
| 3-5 | 在蓉单位承担国家核高基重大专项 |
| 3-6 | 建设综合性集成电路公共服务平台 |
| 3-7 | 企业建设集成电路领域国家级企业技术中心、技术创新中心、工程研究中心、重点实验室 |
| 3-8 | 金融机构为集成电路企业提供金融产品和服务 |
| 四 | 营造集成电路设计人才安居乐业环境类 | 4-1 | 集成电路设计企业中高端人才奖励 |
| 4-2 | 集成电路相关紧缺专业应届毕业生租房补贴 |

附件2：

编号：

2019年成都市集成电路项目资金

申报书

（支持集成电路企业加快发展类）

企业（单位）名称（盖章）：

项目名称：

所属区（市）县：

联 系 人：

联系电话：

填报日期：

成都市经济和信息化局 成都市财政局制

项目申报书编制说明

一、本申报书是按照《市政府办公厅关于印发进一步支持集成电路产业项目加快发展若干政策措施的通知》（成办函〔2018〕47 号）、《成都市经济和信息化委员会 成都市财政局进一步支持集成电路产业项目加快发展若干政策措施实施细则》（成经信财〔2018〕65号）及《市政府办公厅关于印发支持集成电路设计业加快发展的若干政策》（成办函〔2018〕194号）、《成都市经济和信息化局 成都市财政局支持集成电路设计业加快发展的若干政策实施细则》（成经信财〔2019〕4号）精神的要求制定，是申请成都市集成电路项目资金的依据。

二、本类别支持子项目类别有：首次全掩膜（Full Mask）工程产品和多项目晶圆（MPW）流片，采购本地企业自主研发设计生产的芯片，向 IP提供商购买IP进行研发，设计平台提供IP复用、共享设计工具软件等服务，化合物半导体全掩膜首轮验证性流片，在本地进行封装和测试。

三、格式要求：

（一）统一用A4纸，目录之后双面印制。

（二）按照给定格式编写，除封面外，正文为方正仿宋简体。

（三）申报书胶印装订成册，封面用浅蓝色书皮打印，每个子项目类别单独成册，每册申报书一式肆份。

（四）装订顺序：1.封面；2.目录；3.单位简介；4.加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证（复印件）；5.申报子项目类别相关资料（按资料清单顺序编排）。

（五）区（市）县汇总表采用Excel 文件格式。

四、申报书未尽事宜，可另附文字材料说明。

五、单位承诺、加载统一社会信用代码的营业执照等申报材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位（企业）鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

**目 录**

[一、企业简介](#_Toc1553512)

[二、加载统一社会信用代码的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件](#_Toc1553514)

[三、申报子项目类别相关资料](#_Toc1553515)

（相关申报材料清单按照顺序编排）

一、企业简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 法人代表 |  |
| 公司地址 |  | 员工人数 |  |
| 所属区县 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 细分领域 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 税收征管地 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 联系人 | 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 |  电子邮件 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 企业基本情况 | 所有制形式 | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营 □其他 |
| 主要股东及其持股比例 |  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
|  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
| 企业简要介绍 | 1.公司历史沿革2.公司规模结构3.主营业务方向4.集成电路产业方面发展现状 |
| 主营产品（服务）及高技术含量产品 |  |
| 核心竞争技术（优势） | 企业核心竞争技术、自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记、软件著作权等）等方面情况 |
| 企业财务状况 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 资产负债率（%） |
|  |  |  |  |
| 过往三年经营状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 主营收入增长率（%） | 净利润（万元） | 净利润增长率（%） | 税收（万元） | 研发占比(%) |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。 法定代表人（签字）： 承诺单位（公章）  2019年 月 日 |

二、加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证复印件

三、申报子项目类别相关资料

（以下为项目资金申报表、材料清单等内容）

附表1-1

首次全掩膜（Full Mask）工程产品和多项目晶圆（MPW）流片补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，公司首轮全掩膜（Full Mask）工程产品流片情况 | 委托本市集成电路制造企业完成流片 | 首轮流片总费用（万元） |  |
| 申报补贴金额（万元） |  |
| 委托非本市集成电路制造企业完成流片 | 首轮流片总费用（万元） |  |
| 申报补贴金额（万元） |  |
| 申报期内，公司使用多项目晶圆（MPW）流片情况 | 流片总费用（万元） |  |
| 申报补贴金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.工程流片加工业务统计表，与集成电路制造企业签订的工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）；通过第三方服务平台委托流片，需提供委托加工工程流片加工业务统计表、与服务平台之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证及服务平台与集成电路制造企业之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业和服务平台鲜章）； |
| 2.芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.MPW或工程流片产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明、市场销售证明材料等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.反映企业自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权、企业技术中心等）复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.企业近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 8.供需双方企业无关联关系承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。 法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
| 区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

流片加工业务统计表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 服务商所在城市 | 工艺类型/线宽 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与流片服务商 及服务商之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月 日

附表1-2

采购本地企业自主研发设计生产的芯片

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，采购本市IC设计企业自主设计的芯片产品情况 | 采购金额（万元） |  |
| 申报补助金额（万元） |  |
| 所采购芯片是否用于本企业具有自主知识产权的系统（整机）、终端产品 | □是 □否 | 使用所采购芯片生产出产品的产值（万元） |  |
| 公司近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.与本市IC设计企业签订的合作协议和订货合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.IC设计企业的芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.反映IC设计企业产品自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.产品情况简介，产品销售或被采购应用的相关证明材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业、单位参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证等相关材料复印件）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 8.供需双方企业无关联关系承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

本市芯片采购情况统计表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 芯片提供商名称 | 芯片提供商所在区（市）县 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **合计** | 　 |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与芯片提供商 及提供商之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月 日

附表1-3

向 IP提供商购买IP进行研发

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，累计采购本市IP（含Foundry IP模块）金额（万元） |  |
| 是否用所购IP开展符合我市重点发展方向的先进工艺（最小线宽≤14nm）或化合物半导体工艺（晶圆不小于6英寸）研发 | □是□否 |
| 采购本市 IP用于研发形成的产值（万元） |  | 申报补助金额（万元） |  |
| 公司近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.IP采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件等（加盖申报企业鲜章）；  |
| 2.与集成电路制造企业签订的工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）;通过市级以上服务平台委托流片，需提供委托加工工程流片加工业务统计表、与服务平台之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证及服务平台与集成电路制造企业之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业和服务平台鲜章）； |
| 3.芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.购买IP的研发产品情况简介（加盖申报单位鲜章）及产品供销合同（加盖供需双方鲜章）；  |
| 5.公司近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）；  |
| 7.其它补充支撑材料（含采购产品的知识产权证书、参与国家/省/市级项目情况、近两年财务情况、品牌知名度证明文件、单位资质、发明专利情况、单位信用证明、产品购销合同等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 8.供需双方无关联关系承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与服务商 及服务商之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月 日

本市IP采购情况统计表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | IP提供商名称 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

附表1-4

设计平台提供IP复用、共享设计工具软件等服务补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| IP复用、共享设计工具软件、测试与分析系统服务金额（万元） |  | 申请补助金额（万元） |  |
| 公司近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1. IP复用、共享设计工具软件或测试与分析系统的采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件等（加盖申报单位鲜章）； |
| 2.平台概况（包括建设背景、建设内容、技术、各项目建设条件落实），平台服务主要企业名单，以及与IC企业签订的服务合同、发票及银行划款凭证等相关服务绩效证明材料复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 3.正版软件使用证明复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.公司近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（含采购产品的知识产权证书、参与国家/省/市级项目情况、近两年财务情况、品牌知名度证明文件、单位资质、发明专利情况、单位信用证明、产品购销合同等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.供需双方无关联关系承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与服务企业 及服务企业之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月 日

IP复用、共享设计工具软件等服务情况汇总表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 服务企业名称 | 服务企业所在区（市）县 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

附表1-5

化合物半导体全掩膜首轮验证性流片

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，提供化合物半导体全掩膜首轮验证性无偿试流片情况（制造企业填写） | 提供首轮流片的累计总成本费用（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报期内，在本市进行化合物半导体全掩膜首轮验证性有偿试流片情况（设计企业填写） | 首轮流片累计费用（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.工程流片加工情况表，与本市集成电路制造企业签订的工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）；若企业是通过服务平台委托流片，还需提供与服务平台之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证及服务平台与集成电路制造企业之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.工程流片产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明、市场销售证明材料等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.反映企业自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权、企业技术中心等）复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.公司近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等）（加盖申报企业鲜章）； |
|  | 8.供需双方企业无关联承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

化合物半导体全掩膜首轮验证性流片加工情况表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 合作单位名称 | 合作单位所属地 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与合作企业 及合作企业之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月

附表1-6

在本地进行封装和测试补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，在本地进行芯片封装情况 | 芯片封装总费用（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报期内，在本地进行芯片测试情况 | 芯片测试总费用（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.封装、测试业务统计表，与本市集成电路企业签订的封装或测试合作协议和合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.反映产品自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明、市场销售证明材料等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章） |
| 6.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 8.供需双方企业无关联承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

封装、测试业务统计表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 封装/测试 | 封装/测试服务商名称 | 封装技术（仅封装业务填写） | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

无关联关系承诺书

本公司郑重承诺，本公司及本公司之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员与流片服务商 及服务商之关联公司（包括公司所投资的子公司及其他经济实体、公司所属上级母公司及其所投资的子公司及其他经济实体，无论参股或控股）之法定代表人、股东、公司董事会成员及其他高级管理人员之间没有任何亲属关系等身份上和经济利益上的利害关系（包括但不限于实名股东、隐名股东、代持股份，以及股利分配、公司利益分配等利益上的利害关系）。

承诺单位（加盖公章）：

 年 月 日

附件3：

编号：

2019年成都市集成电路

项目资金申报书

（鼓励高校院所支持集成电路产业发展类）

企业（单位）名称（盖章）：

项目名称：

联 系 人：

联系电话：

填报日期：

成都市经济和信息化局 成都市财政局制

项目申报书编制说明

一、本申报书是按照《市政府办公厅关于印发支持集成电路设计业加快发展的若干政策》（成办函〔2018〕194号）、《成都市经济和信息化局 成都市财政局支持集成电路设计业加快发展的若干政策实施细则》（成经信财〔2019〕4号）精神的要求制定，是申请成都市集成电路项目资金的依据。

二、本类别支持子项目类别有：国际国内一流高校在蓉建设国家示范性微电子学院、在蓉高校或科研院所新设立微电子相关专业的学院，在蓉高校科研院所扩大集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士招生规模，在蓉高校科研院所集成电路设计相关专业学生教学流片，在蓉高校科研院所承接本地设计企业急需的技术攻关。

三、格式要求：

（一）统一用A4纸，目录之后双面印制。

（二）按照给定格式编写，除封面外，正文为方正仿宋简体。

（三）申报书胶印装订成册，封面用浅蓝色书皮打印，每个子项目类别单独成册，每册申报书一式肆份。

（四）装订顺序：1.封面；2.目录；3.单位简介；4.加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证（复印件）；5.申报子项目类别相关资料（按资料清单顺序编排）。

（五）区（市）县汇总表采用Excel 文件格式。

四、申报书未尽事宜，可另附文字材料说明。

五、单位承诺、加载统一社会信用代码的营业执照等申报材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位（企业）鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

**目 录**

[一、企业简介](#_Toc1553512)

[二、加载统一社会信用代码的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件](#_Toc1553514)

[三、申报子项目类别相关资料](#_Toc1553515)

（相关申报材料清单按照顺序编排）

一、单位简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| 单位地址 |  | 员工人数 |  |
| 所属区县 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| 学院负责人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 |  电子邮件 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 单位基本情况 | 单位简要介绍 | （历史沿革、规模结构、在集成电路方面发展现状等，400字以内） |
| 核心竞争技术（优势） | 单位核心竞争技术、自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记、软件著作权等）等方面情况 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；  法定代表人（签章）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

二、加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证复印件三、申报子项目类别相关资料

（以下为项目资金申报表、材料清单等内容）附表2-1

国际国内一流高校在蓉建设国家示范性微电子学院、在蓉高校或科研院所新设立微电子

相关专业的学院补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，在蓉建设国家示范性微电子学院情况 | 国家对示范性微电子学院的批复时间 |  |
| 建设总经费（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报期内，在蓉新设立微电子相关专业学院情况 | 新设立微电子相关专业的认定时间 |  |
| 建设总经费（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况（以示范性微电子学院或微电子相关专业学院为申报主体所获得的国、省、市财政资金支持项目） | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.国家对示范性微电子学院的批复文件，对新设立微电子相关专业的认定文件（加盖申报单位鲜章）； |
| 2.建设方案（应包括建设目标、建设内容、进度安排、经费预算等）（加盖申报单位鲜章）； |
| 3.学院学科介绍材料（招生培养情况、毕业生去向报告、课程设置、师资安排、培养计划、软硬件资源、科研成果、影像资料）（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.固定资产、学科建设的投入证明及相关会计资料、票据、凭证（加盖申报单位鲜章）； |
| 5.支持经费预算和用途（二级单位负责人签字，加盖申报单位鲜章）； |
| 6.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报单位鲜章）； |
| 7.由第三方专业机构出具的申报学院上一年度的审计报告，或者高校科研院所出具的申报学院上一年度财务评估报告（加盖申报单位鲜章）； |
| 8.其它补充支撑材料（单位参与国家/省/市级项目情况、发明专利情况、获奖情况等）（加盖申报单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金。 法定代表人（签章）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

附表2-2

在蓉高校科研院所扩大集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士

招生规模补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，单位招收集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士情况 | 招收非全日制工程硕士人数 |  |
| 招收非全日制工程博士人数 |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报材料清单 | 1.非全日制工程硕士和博士培养的高校和企业人才联合培养协议复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 2.非全日制工程硕士和博士所在企业缴纳社保的证明（加盖所在企业鲜章）； |
| 3.高校和科研院所集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士的详细名单和本人签名，身份证和入学通知书复印件，学籍证明（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.其它补充支撑材料（专业介绍、培养计划、就业方向、师资配备等）（加盖申报单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金。  法定代表人（签章）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 所在企业 | 入学时间 | 身份证号 | 专业 | 学位 | 联系方式 | 本人签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2-3

在蓉高校科研院所集成电路设计相关专业学生教学流片补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，单位在读本科生和研究生毕业设计教学流片费用总金额（万元） |  | 申请补助金额（万元） |  |
| 申报材料清单 | 1.与集成电路制造企业签订的工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报单位鲜章）；通过服务平台委托流片，需提供与服务平台之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证及服务平台与集成电路制造企业之间的流片加工合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报单位和服务平台鲜章）； |
| 2.芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 3.反映高校和科研院所教学创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.学生毕业设计开题报告、中期报告，毕业论文大纲等反映毕业设计流片必要性的佐证材料（加盖申报单位鲜章）； |
| 5.其它补充支撑材料（单位参与国家/省/市级项目情况、发明专利情况、获奖情况、本科评估等）（加盖申报单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金。 法定代表人（签章）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

集成电路设计相关专业学生教学流片明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 毕业设计题目 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高校及学院 | 导师 | 流片时间 | 流片金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

附表2-4

在蓉高校科研院所承接本地设计企业急需的技术攻关项目补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，承接本地设计企业急需的技术攻关项目情况 | 金额不低于50万元的横向合同总金额（万元） |  |
| 实际付款总金额（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报材料清单 | 1.项目汇总表（加盖申报单位鲜章）；与本市IC企业签订的技术攻关横向合同、项目计划书、项目任务书、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报单位和企业鲜章）； |
| 2.反映技术攻关创新能力的证明材料（成果介绍、获得的专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件（加盖申报单位鲜章）； |
| 3.承担技术攻关项目团队成员的身份证（复印件），团队成员简历（本人签名）等（加盖申报单位鲜章）； |
| 4.补助金分配方案（团队成员签名）（加盖申报单位鲜章）； |
| 5.其它补充支撑材料（参与国家/省/市级项目情况、获奖情况等）（加盖申报单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金。 法定代表人（签章）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

技术攻关项目汇总表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术攻关项目名称 | 相关高校院所 | 服务企业名称 | 横向合同签订时间 | 横向合同金额 | 实际付款金额 | 开票时间（年月日） | 发票内容 | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

附件4：

编号：

2019年成都市集成电路项目资金

申报书

（为产业发展提供创新支撑类）

企业（单位）名称（盖章）：

项目名称：

所属区（市）县：

联 系 人：

联系电话：

填报日期：

成都市经济和信息化局 成都市财政局制

项目申报书编制说明

一、本申报书是按照《市政府办公厅关于印发支持集成电路设计业加快发展的若干政策》（成办函〔2018〕194号）、《成都市经济和信息化局 成都市财政局支持集成电路设计业加快发展的若干政策实施细则》（成经信财〔2019〕4号）精神的要求制定，是申请成都市集成电路项目资金的依据。

二、本类别支持子项目类别有：新获批省级和国家级博士后工作站，重点企业与高校科研院所共建集成电路设计类工程技术研发中心，企业自主兴办集成电路设计类职业培训机构，重点企业与高校科研院所共建综合培训实践基地，在蓉单位承担国家核高基重大专项，建设综合性集成电路公共服务平台，企业建设集成电路领域国家级企业技术中心、技术创新中心、工程研究中心、重点实验室，金融机构为集成电路企业提供金融产品和服务。

三、格式要求：

（一）统一用A4纸，目录之后双面印制。

（二）按照给定格式编写，除封面外，正文为方正仿宋简体。

（三）申报书胶印装订成册，封面用浅蓝色书皮打印，每个子项目类别单独成册，每册申报书一式肆份。

（四）装订顺序：1.封面；2.目录；3.单位简介；4.加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证（复印件）；5.申报子项目类别相关资料（按资料清单顺序编排）。

（五）区（市）县汇总表采用Excel 文件格式。

四、申报书未尽事宜，可另附文字材料说明。

五、单位承诺、加载统一社会信用代码的营业执照等申报材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位（企业）鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

**目 录**

[一、企业简介](#_Toc1553512)

[二、加载统一社会信用代码的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件](#_Toc1553514)

[三、申报子项目类别相关资料](#_Toc1553515)

（相关申报材料清单按照顺序编排）

一、单位简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★单位名称 |  | ★法人代表 |  |
| ★单位地址 |  | ★员工人数 |  |
| ★所属区县 |  | ★成立时间 |  |
| ★注册地址 |  | 细分领域 |  |
| ★开户银行 |  | ★帐 号 |  |
| 税收征管地 |  | ★统一社会信用代码 |  |
| ★联系人 | 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 |  电子邮件 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 单位基本情况 | 所有制形式 | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营 □其他 |
| 主要股东及其持股比例 |  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
|  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
| ★单位简要介绍 | （历史沿革、规模结构、在集成电路方面发展现状等，400字以内） |
| 主营产品（服务）及高技术含量产品 |  |
| ★核心竞争技术（优势） | 单位核心竞争技术、自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记、软件著作权等）等方面情况 |
| 单位财务状况 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 资产负债率（%） |
|  |  |  |  |
| 过往三年经营状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 主营收入增长率（%） | 净利润（万元） | 净利润增长率（%） | 税收（万元） | 研发占比(%) |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、近三年未被列入单位异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

说明：申报主体为企业的，须填写表格所有栏目；申报主体为高校院所的，标“★”栏目为必填项，其余栏目为选填项。二、加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证复印件三、申报子项目类别相关资料

（以下为项目资金申报表、材料清单等内容）

附表3-1

新获批省级和国家级博士后工作站

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 工作站获批时间 |  | 工作站类别 | □国家级 □省级 | 申报期内，新获准进站博士后人数 |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 公司近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单（新获批省级和国家级博士后工作站补助） | 1.国家或省级博士后工作站批复文件复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.工作站概况（包括建设背景、建设内容、技术、依托项目及建设条件、进站博士后名单及去向等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.建设投入佐证材料及相关会计资料、票据、凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证、影像资料等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 申报材料清单（新获准进站博士后补助） | 1.身份证或护照等有效证件复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.毕业证、学位证,国（境）外博士另提供学历学位认证书复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.主管部门批准博士后进站文件复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.开题报告、中期报告、出站报告，论文、专利，软件著作权、版图等研究成果，科研经费申请表等证明材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.联合培养协议复印件（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

新获准进站博士后名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 博士后姓名 | 所在单位 | 联合培养协议签订时间 | 获准进站批复时间 | 身份证号 | 专业 | 学历 | 联系方式 | 备注 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |  |

附表3-2

重点企业与高校科研院所共建集成电路设计类工程技术研发中心补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 共建协议签订时间 |  | 共建研发中心名称 |  |
| 软硬件投入（万元） |  | 高级及以上职称专家人数 |  |
| 申报期内设备或软件投入（万元） |  | 其中企业投入占比（%） |  |
| 申报期内获得集成电路类发明专利数量（项） |  | 其中企业获得集成电路类发明专利数量（项） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.企业和高校共建工程技术研发中心协议复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.建设方案（应包括建设目标、建设内容、人员名单及高级职称证明、进度安排、经费预算等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.建设投入佐证材料及相关会计资料、票据、凭证，发明专利情况等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（中心参与国家/省/市级项目情况、研发成果情况、研发支出情况、获奖情况、影像资料等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表3-3

企业自主兴办集成电路设计类职业培训机构补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 机构名称 |  | 机构在市级以上人社部门备案时间 |  |
| 员工总人数 |  | 上一年度营业收入（万元） |  |
| 具备5年以上IC设计工作经历的培训师人数 |  | 申报期内累计培养设计行业技能人才人数 |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.培训机构在市级以上人社部门备案文件复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.机构基本情况（应包括目标内容、课程设置、学时安排、经费预算、教员信息、培训人员名单及去向等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.软硬件设施的投入证明（投入明细表、合同、发票、付款凭证等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.由会计师事务所出具的本企业上一年度审计报告（包含员工总人数，培训总人数，培训投入）（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明及相关凭证、培训机构社会认可度佐证材料、影像资料等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表3-4

重点企业与高校科研院所共建综合培训实践基地补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 实训基地名称 |  | 共建协议签订时间 |  |
| 员工总人数 |  | 上一年度营业收入（万元） |  |
| 申报期内累计培训实践型工程硕士人数 |  | 申报期内累计培训实践型工程博士人数 |  |
| 申报期内每个学员累计培训时长不短于6个月 | □是□否 | 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.经实践学生所在高校科研院所盖章确认的共建实训基地的协议，区级以上人社部门出具的备案材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.实训方案（应包括实训目标、实训内容、进度安排、经费预算、师资情况、取得成效等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.实训人员名单、时长、去向，实训记录，实训影像资料等（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.实训基地建设和实训活动相关的支出证明及会计资料、票据、凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 企业承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

实训人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 所在高校院所 | 培训时长 | 身份证号 | 专业 | 学位 | 联系方式 | 备注 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
|  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
|  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |  |

附表3-5

在蓉单位承担国家核高基重大专项

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 国家核高基重大专项项目名称 |  | 立项时间 |  |
| 配套资金金额要求（万元） | □有 金额（万元）： □无 |
| 配套资金比例要求（%） | □有 比例（%）： □无 |
| 国家经费实际到位金额（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.国家集成电路类科技重大专项（课题）立项批文、合同书和任务书复印件；国家科技重大专项组织单位要求地方配套的依据文件复印件（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 2.国家拨款银行到账凭证（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 3.国家重大专项项目申报方案（应包括目标、内容、进度安排、经费预算、人员名单等）（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 5.由会计师事务所出具的本企业或单位上一年度审计报告（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业、单位参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证等）（加盖申报企业或单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、近三年未被列入单位异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表3-6

建设综合性集成电路公共服务平台

补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 平台名称 |  | 获批时间 |  |
| 平台类别 | □国家级 □省级 | 平台建设运维投入金额（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 单位近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.获得国家或省批准平台成立的批复文件复印件（必要时检查原件）（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 2.平台建设方案（应包括建设目标、建设内容、进度安排、经费预算、培训人员名单等）（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 3.建设投入佐证材料及相关会计资料、票据、凭证等相关材料复印件（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明，平台服务主要企业名单，发票及银行划款凭证等相关服务绩效证明材料复印件（加盖申报企业或单位鲜章）； |
| 5.其它补充支撑材料（平台参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、发明专利情况、市场应用购销合同及相关凭证等）（加盖申报企业或单位鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、近三年未被列入单位异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表3-7

企业建设集成电路领域国家级企业技术

中心、技术创新中心、工程研究中心、重点实验室补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 项目名称 |  | 获批时间 |  |
| 项目类别 | □企业技术中心 □技术创新中心 □工程研究中心 □重点实验室 |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 近两年获得财政资金支持的项目情况 | 2017年 | 序号 | 项目名称 | 资金拨付单位 | 获得补助金额（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 2018年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |
| 申报材料清单 | 1.获得国家级企业技术中心、创新中心、工程研究中心、重点实验室称号的企业批复认定（核定）文件（复印件）（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.建设方案（应包括建设目标、建设内容、进度安排、经费预算、影像资料等）（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.建设投入佐证材料及相关会计资料、票据、凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.近两年获得财政资金支持的项目情况说明（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本公司已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本公司承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本公司承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表3-8

金融机构为集成电路企业提供金融产品和服务补助资金申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 申报期内，给予本地非上市集成电路企业发放中长期（3年以上）贷款，提供债券、融资租赁、供应链金融产品的实际投放金额（万元） |  |
| 申请补助金额（万元） |  |
| 申报材料清单 | 1.银行出具的发行备案文件以及资金募集证明（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.划款凭证、认购债券、融资租赁单、银行进账单等相关证明资料（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.支持企业清单，支持明细（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.企业利用资金情况的证明材料（加盖扶持企业鲜章）； |
| 5.企业与金融机构签订的服务协议或其他证明文件复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.其它补充支撑材料（金融机构简介，服务企业名单等）（加盖申报企业鲜章）。 |
| 单位承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入单位异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。  法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

服务企业清单

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务企业名称 | 所属区（市）县 | 企业是否上市 | 服务类别 | 服务方式 | 发票内容 | 开票时间（年月日） | 发票代码 | 发票号码 | 发票金额 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

说明：服务类别选填中长期贷款/债券/融资租赁/供应链金融；服务方式选填非固定资产抵押/固定资产抵押。

 非上市企业包括未在主板、中小板、创业板、科创板挂牌上市，也未在境外交易所挂牌上市的企业。

附件5：

编号：

2019年成都市集成电路项目资金

申报书

（营造集成电路设计人才安居乐业环境类）

企业（单位）名称（盖章）：

项目名称：

所属区（市）县：

联 系 人：

联系电话：

填报日期：

成都市经济和信息化局 成都市财政局制

项目申报书编制说明

一、本申报书是按照《市政府办公厅关于印发支持集成电路设计业加快发展的若干政策》（成办函〔2018〕194号）、《成都市经济和信息化局 成都市财政局支持集成电路设计业加快发展的若干政策实施细则》（成经信财〔2019〕4号）精神的要求制定，是申请成都市集成电路项目资金的依据。

二、本类别支持子项目类别有：集成电路设计企业中高端人才奖励、集成电路相关紧缺专业应届毕业生租房补贴。

三、格式要求：

（一）统一用A4纸，目录之后双面印制。

（二）按照给定格式编写，除封面外，正文为方正仿宋简体。

（三）申报书胶印装订成册，封面用浅蓝色书皮打印，每个子项目类别单独成册，每册申报书一式肆份。

（四）装订顺序：1.封面；2.目录；3.单位简介；4.加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证（复印件）；5.申报子项目类别相关资料（按资料清单顺序编排）。

（五）区（市）县汇总表采用Excel 文件格式。

四、申报书未尽事宜，可另附文字材料说明。

五、单位承诺、加载统一社会信用代码的营业执照等申报材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位（企业）鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

**目 录**

[一、企业简介](#_Toc1553512)

[二、加载统一社会信用代码的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件](#_Toc1553514)

[三、申报子项目类别相关资料](#_Toc1553515)

（相关申报材料清单按照顺序编排）

一、企业简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 法人代表 |  |
| 公司地址 |  | 员工人数 |  |
| 所属区县 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 细分领域 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 税收征管地 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 联系人 | 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 |  电子邮件 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 企业基本情况 | 所有制形式 | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营 □其他 |
| 主要股东及其持股比例 |  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
|  | 持股金额 (万元) |  |
|  | 持股比例(%) |  |
| 企业简要介绍 | 1.公司历史沿革2.公司规模结构3.主营业务方向4.集成电路产业方面发展现状 |
| 主营产品（服务）及高技术含量产品 |  |
| 核心竞争技术（优势） | 企业核心竞争技术、自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记、软件著作权等）等方面情况 |
| 企业财务状况 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 资产负债率（%） |
|  |  |  |  |
| 过往三年经营状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 主营收入增长率（%） | 净利润（万元） | 净利润增长率（%） | 税收（万元） | 研发占比(%) |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 企业承诺 | 本单位已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位(个人)郑重承诺如下：一、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。   法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |

二、加载统一社会信用代码的营业执照及法定代表人身份证复印件三、申报子项目类别相关资料

（以下为项目资金申报表、材料清单等内容）附表4-1

集成电路设计企业中高端人才奖励

补助资金申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报个人 |  | 所在企业 |  |
| 职务 |  | 人才类别 | □研发人才□高级技术管理人才 |
| 税后收入（万元） |  | 申请补助金额（万元） |  |
| 签订劳动合同年限 |  | 已在企业工作时间 |  |
| 工作岗位 |  | 受刑事处罚情况 | □无□刑事处罚已结束 |
| 申报材料清单 | 1.申请人身份证明信息、申报人学位学历证明、任职文件、劳动合同复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.企业逐月支付申报人工资薪金、奖金分红等证明（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.个人所得税完税证明、企业所得税完税证明（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.企业缴纳申报人的社保材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.企业法人提供统一社会信用代码营业执照复印件和法定代表人身份证复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（参与项目、取得成果、获得荣誉）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.申报材料真实性及不重复申报承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 单位(个人)承诺 | 本单位(个人)已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位(个人)郑重承诺如下：一、本单位(个人)承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位(个人)承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位(个人)承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。 申请人签名：单位法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

附表4-2

集成电路相关紧缺专业应届毕业生租房

补贴资金申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报个人 |  | 所在企业 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业院校 |  |
| 院校排名情况 | 上一年度QS、THE、USNEWS学校前100（ ）双一流高校（ ）在蓉科研院所（ ） | 申请补助金额（万元） |  |
| 签订劳动合同年限 |  | 已在企业工作时间 |  |
| 从事工作岗位 |  | 受刑事处罚情况 | □无□刑事处罚已结束 |
| 申报材料清单 | 1.申请人身份证明信息、申报人学位学历证明、任职文件、劳动合同复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 2.企业逐月支付申报人收入证明（加盖申报企业鲜章）； |
| 3.申报期未享受成都市人才房和保障房的佐证材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 4.企业缴纳申报人的社保材料（加盖申报企业鲜章）； |
| 5.企业法人提供统一社会信用代码营业执照复印件和法定代表人身份证复印件（加盖申报企业鲜章）； |
| 6.其它补充支撑材料（参与项目、取得成果、获得荣誉）（加盖申报企业鲜章）； |
| 7.申报材料真实性及不重复申报承诺书（加盖申报企业鲜章）。 |
| 单位(个人)承诺 | 本单位(个人)已认真阅读了2019年成都市集成电路专项资金项目申报通知的全部内容，清楚并理解2019年成都市集成电路专项资金项目申报的条件、材料、时间和程序等相关要求，现本单位(个人)郑重承诺如下：一、本单位(个人)承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目真实，不存在伪造、变造、抄袭等虚假情形；二、本单位(个人)承诺本次申报的2019年成都市集成电路专项资金项目的申报资料真实、合法、有效；三、本单位(个人)承诺本项目未曾享受过国家、省上或市级其他同类政策项目的奖补资金；四、近三年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生重、特大安全事故以及环境污染事故等“一票否决”事项。 申请人签名：单位法定代表人（签字）： 单位（公章）  2019年 月 日 |
|  区（市）县工业和信息化主管部门审核 （盖章）2019年 月 日   | 区（市）县财政部门审核（盖章）2019年 月 日  |

申报人清单（按企业）

**单位（公章） 年 月 日 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报人姓名 | 身份证号码 | 开始缴纳社保时间（年月日） | 所在企业名称 | 企业社会信用代码 | 毕业院校及专业 | 签订合同时间（年月日） | 申报金额 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |

说明：以企业为单位，代为申报本单位申报人的相关申报信息，企业将本单位所有的申报人还要填入申报人清单（加盖企业鲜章）。

附件6：

2019年成都市集成电路项目资金申报统计汇总表

（区（市）县填写）

|  |  |
| --- | --- |
| 区（市）县工业和信息化主管部门（盖章）：  | 区（市）县财政主管部门（盖章）： |
| 联系人：  | 联系电话： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 序号 | 单位名称 | 所在区（市）县 | 联系人 | 联系方式 | 项目大类名称 | 子项目类别名称 | 申报金额（万元） | 备注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

填表说明：1.每个项目单独填写一行，同一家单位申报多个项目则填写多行；

2.项目大类及子项目类别名称：

①支持集成电路企业加快发展类

包括首次全掩膜（Full Mask）工程产品和多项目晶圆（MPW）流片，采购本地企业自主研发设计生产的芯片，向 IP提供商

购买IP进行研发，设计平台提供IP复用、共享设计工具软件等服务，化合物半导体全掩膜首轮验证性流片，在本地进行

封装和测试6个项目类别。

②鼓励高校院所支持集成电路产业发展类

包括国际国内一流高校在蓉建设国家示范性微电子学院、在蓉高校或科研院所新设立微电子相关专业的学院，在蓉高校科

研院所扩大集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士招生规模，在蓉高校科研院所集成电路设计相关专业学生

教学流片，在蓉高校科研院所承接本地设计企业急需的技术攻关4个项目类别。

③为产业发展提供创新支撑类

包括新获批省级和国家级博士后工作站，重点企业与高校科研院所共建集成电路设计类工程技术研发中心，企业自主兴办

集成电路设计类职业培训机构，重点企业与高校科研院所共建综合培训实践基地，在蓉单位承担国家核高基重大专项，建

设综合性集成电路公共服务平台，企业建设集成电路领域国家级企业技术中心、技术创新中心、工程研究中心、重点实验

室，金融机构为集成电路企业提供金融产品和服务等8个项目类别。

④营造集成电路设计人才安居乐业环境类

包括集成电路设计企业中高端人才奖励、集成电路相关紧缺专业应届毕业生租房补贴2个项目。

附件7：

2019年成都市集成电路项目资金申报统计汇总表

（高校科研院所填写）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位（盖章）：  |  |
| 联系人：  | 联系电话： | 　 | 　 |
| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 项目大类名称 | 子项目类别名称 | 申报金额（万元） | 备注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

填表说明：1.每个项目单独填写一行，同一家单位申报多个项目则填写多行；

2.项目大类及子项目类别名称：

①支持集成电路企业加快发展类

包括首次全掩膜（Full Mask）工程产品和多项目晶圆（MPW）流片，采购本地企业自主研发设计生产的芯片，向 IP提供商

购买IP进行研发，设计平台提供IP复用、共享设计工具软件等服务，化合物半导体全掩膜首轮验证性流片，在本地进行

封装和测试6个项目类别。

②鼓励高校院所支持集成电路产业发展类

包括国际国内一流高校在蓉建设国家示范性微电子学院、在蓉高校或科研院所新设立微电子相关专业的学院，在蓉高校科

研院所扩大集成电路相关紧缺专业非全日制工程硕士和工程博士招生规模，在蓉高校科研院所集成电路设计相关专业学生

教学流片，在蓉高校科研院所承接本地设计企业急需的技术攻关4个项目类别。

③为产业发展提供创新支撑类

包括新获批省级和国家级博士后工作站，重点企业与高校科研院所共建集成电路设计类工程技术研发中心，企业自主兴办

集成电路设计类职业培训机构，重点企业与高校科研院所共建综合培训实践基地，在蓉单位承担国家核高基重大专项，建

设综合性集成电路公共服务平台，企业建设集成电路领域国家级企业技术中心、技术创新中心、工程研究中心、重点实验

室，金融机构为集成电路企业提供金融产品和服务等8个项目类别。

④营造集成电路设计人才安居乐业环境类

包括集成电路设计企业中高端人才奖励、集成电路相关紧缺专业应届毕业生租房补贴2个项目。